

宇环数控机床股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第十次会议审议通过了关于公司向银行申请总额不超过人民币6000万元综合授信额度的议案，于2020年8月16日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了关于公司向银行申请总额不超过人民币8000万元综合授信额度的议案。

鉴于2020年申请的部分综合授信额度即将到期，公司于2021年3月23日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案通过后公司综合授信额度累计金额为28000万元。现就相关事宜公告如下：

一、基本情况

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币28000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国际/国内保函等品种。授信有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。

根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2021年3月23日